

※本リリースは鉄鋼研究会へ配布しております。

2025年8月26日

株式会社田中貴金属グループ

田中貴金属工業、SEMICON India 2025に初出展

～インド政府の半導体戦略拡大を背景に、成長市場への貴金属技術展開を強化～



<出展ブースイメージ（ブース番号：469）>

田中貴金属の産業用貴金属事業を展開する田中貴金属工業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：田中 浩一郎）と田中電子工業株式会社（本社：佐賀県神埼郡、代表取締役社長執行役員：山本 俊哉）は、2025年9月2日（火）から9月4日（木）まで、インド・ニューデリーで開催予定の半導体分野最大級の国際展示会「SEMICON India 2025」に初出展いたします（公式サイト：<https://www.semiconindia.org/>）。本展示会では、**次世代半導体、パワーデバイス、循環型経済実現のための貴金属リサイクルに対応する貴金属由来の先端材料およびソリューション**を一挙紹介します。

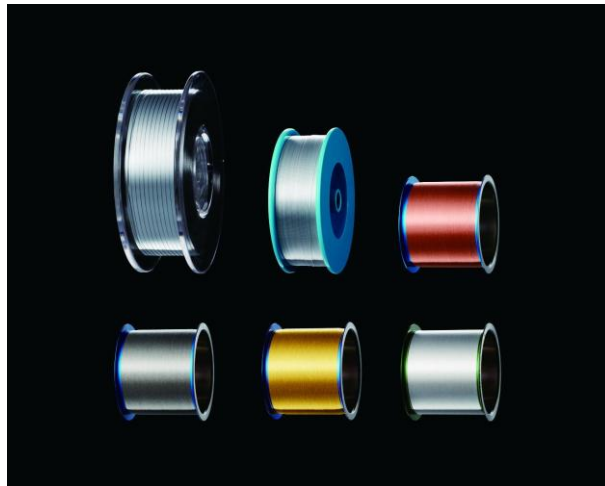
田中貴金属は、**インド・中東・アフリカ市場の戦略的中核拠点**として、2019年12月にムンバイで「田中貴金属（インド）株式会社」を設立しました。これにより、対象地域のお客様との関係をより密にし、市場ニーズに迅速かつ的確に対応できる体制を強化しました。インドが半導体産業の発展を加速させる中、田中貴金属は、世界中で信頼されている貴金属技術と数十年にわたる材料開発の専門性を活かし、その成長を力強く支援いたします。SEMICON India 2025では、インドの先端パッケージングおよびテストエコシステムのニーズに応えるべく、ボンディングワイヤ、銀（Ag）シンタリングペースト、スパッタリングターゲット、精密プローブピン材料などの高性能ソリューションを展示します。

田中貴金属では、貴金属リサイクルにおいて、独自のリサイクル技術とワンストップでのトータルソリューション（ワンストップサービス）を提供しています。貴金属の「調達」から「加工・製造」「販売」、そして「リサイクル」に至るまで、すべての工程を田中貴金属だけで対応できます。これは創業以来培ってきた調達ルート、高度な技術力、製品開発力、研究体制、国内外のネットワークが支える総合力によるものです。ワンストップサービスを通じて、資源の効率的な回収を実現し、サプライチェーンの強靱性を高めることで、循環型経済の推進に貢献しています。今後も、次世代の半導体製造を支える長期的なパートナーとして、持続可能な産業の発展に寄与してまいります。

【主な出展製品】

半導体チップをリードフレームや有機基板に接着（ボンディング実装）する銀（Ag）シンタリングペースト、半導体チップを外部電極と電氣的に接続する金（Au）や銅（Cu）、アルミニウム（Al）などのボンディングワイヤ、検査治具のひとつであるプローブピン、乾式被膜生成材料のターゲットや蒸着材、循環型経済に貢献する貴金属回収精製ソリューションなどです。

- 各種ボンディングワイヤ



<各種ボンディングワイヤ>

電気信号の接続材料として、金（Au）、銀（Ag）、銅（Cu）、アルミニウム（Al）の極細線（10~38 μ m）やパワーデバイス用の太線（100~500 μ m）等のボンディングワイヤおよびリボンを提供しております。表面が平滑かつ清浄で寸法安定性に優れたワイヤを、金属接合のノウハウも含めたソリューションと共に提案します。

- Ag シンタリングペースト



<Ag シンタリングペースト>

パワーデバイス用途の Si（ケイ素/シリコン）、次世代半導体 SiC（シリコンカーバイド）、GaN（窒化ガリウム）に対応するダイボンド用導電性接着剤です。高熱伝導と高信頼性の両立が可能なハイブリッド接合タイプと 200W/m・K を超える高熱伝導シンタリングタイプをラインアップに揃えています。

- スパッタリングターゲット



<スパッタリングターゲット>

ハードディスクドライブ、半導体、水晶デバイス向けに、幅広いスパッタリングターゲット製品を提供しています。約 140 年にわたる貴金属調達力と高純度精製技術を活かし、安定した製品供給を実現しています。高純度化・合金化技術による高性能な貴金属製品の製造に対応しており、原料調達においては厳格な管理を行い、コンプライアンスを徹底するとともに、安定した貴金属調達力により柔軟な納期対応が可能です。また、多様な評価装置・成膜装置を活用し、充実した技術サポートを提供します。研究開発にも積極的に取り組み、多様化するお客様のニーズに的確にお応えしています。

- プローブピン材料



<新材料「TK-SK」>

微細検査向けの高導電・高耐摩耗ピンで、特殊仕様も対応可能です。用途に応じて硬さや曲げ性等の機械的性質、電気抵抗率等の電氣的性質など求められる性能が異なるため、Pd合金、Cu合金、Ir、Rh等様々な材料をラインアップしています。また、近年はポゴピンランジヤー先端部の摩耗低減を目的として硬さ向上の需要がますます高まっています。従来、市場に流通するPd合金の硬さは560HV程度が最大とされていましたが、独自技術により、硬さ640HVに到達する新材料「TK-SK」の開発に成功しました。

- 貴金属回収・精製



<持続可能な半導体産業を実現するためのワンストップサービス>

貴金属の回収・精製から再製造までをワンストップで行うリサイクル体制を、信頼と高度な技術力を基盤に展開しています。田中貴金属は、希少で貴重な資源である貴金属を効率的にリサイクルし、持続可能な社会の実現に貢献しています。

【SEMICON India 2025 出展概要】

■展示会名：SEMICON India 2025

■会 期：2025 年 9 月 2 日（火）～4 日（木） 9:00～17:00 ※インド現地時間

■会 場：Yashobhoomi (IICC)、インド・ニューデリー

■公式サイト：<https://www.semiconindia.org/>

■出 展 社：田中貴金属工業株式会社、田中電子工業株式会社

■ブース番号：469

■主な展示製品：ボンディングワイヤ、Ag シンタリングペースト、ターゲット・蒸着材、プローブピン、
貴金属回収・精製

各製品詳細は下記 URL よりご覧いただけます。

■各種ボンディング製品

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/products/detail/bonding-wires/>

■Ag シンタリングペースト

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/products/detail/silver-adhesive/>

■プローブピン

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/products/detail/probe-pins/>

■スパッタリングターゲット

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/products/detail/sputtering-target-production-using-melting/>

■貴金属回収・精製

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/products/detail/recovery-refining/>

【田中電子工業株式会社】

本社所在地：佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2303-15

設 立：1961年

代 表 者：代表取締役社長執行役員 山本 俊哉

資 本 金：18億8,000万円

売 上 高：297億8,038万3,000円（2024年度）

従 業 員 数：871名（海外子会社含む）（2024年12月31日）

事 業 内 容：高純度各種ボンディングワイヤの製造

会社情報

■田中貴金属について

田中貴金属は1885年（明治18年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年にわたって、産業用貴金属製品の製造・販売ならびに、資産用や宝飾品としての貴金属商品を提供しています。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグループ各社が製造、販売そして技術開発において連携・協力し、製品とサービスを提供しています。2024年度（2024年12月期）の連結売上高は8,469億円、5,591人の従業員を擁しています。

■田中貴金属 産業用貴金属製品グローバルサイト

<https://tanaka-preciousmetals.com>

■製品問い合わせフォーム

田中貴金属工業株式会社

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/inquiries-on-industrial-products/>

■報道機関お問い合わせ先

・株式会社田中貴金属グループ

サステナビリティ・広報本部 広報・広告部

お問い合わせフォーム

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/inquiries-for-media/>